

vorragenden wissenschaftlichen Infrastruktur in Dresden und Sachsen gelang der Aufbau einer großen Mannschaft aus Fachkräften, Ingenieuren und Wissenschaftlern ohne Probleme. Am Ende stammten über 85 Prozent der Belegschaft aus Sachsen.

Dann kam der große Tag. Am 1. Mai 1995 begrüßten unsere Geschäftsführer Dr. Harald Eggers und Hr. Horst Dietel zum ersten Mal die neuen Mitarbeiter im neuen Werk. Am selben Tag wurde wie geplant das erste Fertigungsgerät eingebracht. Jetzt konnte der Hochlauf beginnen.

Der Hochlauf der Fertigung

In den nächsten Wochen war der Standort ein wahres Bienenhaus voller Aktivitäten. Der Baubetrieb lief mit Hochdruck weiter. Gleichzeitig rollten täglich die Lkws mit den neuen Geräten an. Diese mussten im Reinraum an ihre jeweilige Medienver- und -entsorgung angeschlossen werden. Die Arbeitszeit wurde durch die Arbeiten diktiert, die gerade anstanden – neue Gerät auspacken, anschließen, in Betrieb nehmen, neue Software ausprobieren sowie Messgeräte testen. Jeder half jedem. Manchmal vergaß man, tagsüber irgendetwas zu essen. Am Abend bot dann für die Neu-Dresdner oftmals der 24-h-Shop einer nahe gelegenen Tankstelle die letzte Versorgungsmöglichkeit. Eigenverantwortung und Unternehmergeist wurden gelebt. Im Oktober 1995 wurden die ersten vollständig prozessierten Silizium-Scheiben fertig gestellt. Am 10. November wurde dieser Erfolg mit der offiziellen Einweihung, zu der 500 Gäste, künftige Kunden, beteiligte Zulieferer, politische Repräsentanten und Mitarbeiter eingeladen waren, gefeiert. Auch EU-Präsident Santer beehrte uns mit seinem Besuch.

Im April 1996 waren dann die 16-Mbit-Speicher »Made in Dresden« bei den ersten Kunden qualifiziert. Das Werk konnte damit seine Produkte verkaufen. Das zweite Modul wurde in Betrieb genommen. Schnell waren alle geplanten Fertigungsgeräte aufgestellt, und die Produktion erreichte zum ersten Mal die geplante volle Auslastung.

Auf dem Weg von 200 mm zu 300 mm

Um die Kosten pro bit mit der geforderten Rate von etwa 30 Prozent pro Jahr zu verringern, wurden in der Vergangenheit Siliziumscheiben mit immer größerem Durchmesser eingesetzt. Über die Jahre war man von etwa 50 mm großen bis zu 200 mm großen Scheiben gelangt. Diese Scheibengröße wurde auch für die ersten Fertigungsmodule in Dresden verwendet. Im Jahr 1997 gab es zunehmend stärkere Aktivitäten, die Fertigungstechnologie für die nächste Scheibengröße von 300 mm zu entwickeln. Es gelang im Februar 1998, mit Motorola Inc. einen Partner für ein Joint Venture, ein neues Gemeinschaftsunternehmen SC300 GmbH in Dresden, zu gewinnen. Aufgabe war es, die Fertigungsprozesse für eine Chipherstellung auf 300 mm großen Scheiben zu entwickeln. Etwa 30 Mitarbeiter von Motorola zogen für bis zu drei Jahre nach Dresden, um sich in einem internationalen Team dieser Aufgabe zu stellen. Wie immer waren die Zeitpläne sehr ehrgeizig, der deutsche Teamleiter, Dr. Peter Kücher, mittlerweile als »Mr. 300 mm« weltweit bekannt,